

电子/尖端产品部门



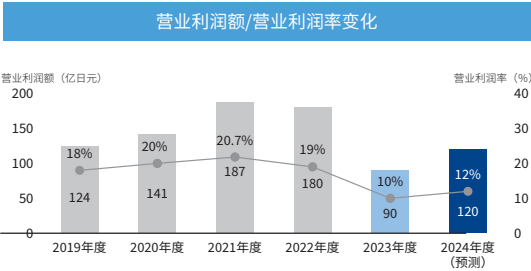
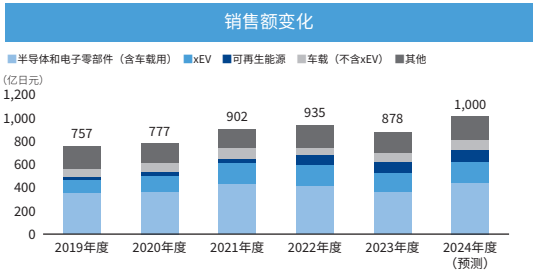
部长致辞

本部门的成长战略核心在于深入理解客户需求，充分运用我司擅长的无机/有机复合技术、热对应技术和高频应对技术，不断为市场及时提供最佳材料解决方案。

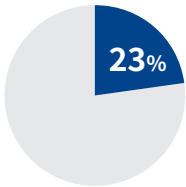
在减轻环境负荷成为当务之急的背景下，我们将通过提供促进数字技术领域发展的高性能材料，为创造更美好的社会贡献力量。

执行役員
电子/尖端产品部门部长
堀内 博人

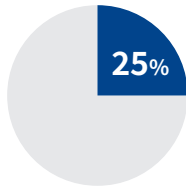
2023年度，我们作出了在泰国成立合资公司生产乙炔炭黑的决定，并加大了各种高功能陶瓷粉的产能扩充等投资，加速推进实现经营计划“Mission 2030”的目标。未来，我们将持续推出兼具“专长”、“大趋势”和“可持续发展”三大要素的新产品，将其培育成为支撑公司发展的核心业务。



占总销售额 (2023年度) 比例



占总销售额的员工比例 (2023年度)



为实现经营计划“Mission2030” 目标而努力

重点领域及市场	【主要产品】	【2023年 业绩】	【2026年 计划】	【部门愿景 (2030年 理想姿态)】
下一代 高速通信	●球状二氧化硅、球状氧化铝 ●低介电二氧化硅 ●低介电有机绝缘树脂 (SNECTON) ●LCP薄膜	●决定将Denka Advantech Pte. Ltd的球状二氧化硅产能提升30% ●决定在泰国成立合资公司，建设年产能11000吨的乙炔炭黑生产设备 ●决定将大牟田工厂的氮化硅生产能力提升50%。 ●完成了用于功率半导体制造工艺的耐热临时固定粘合剂 (TBM) 配方开发，计划于2024年度上市 ●针对SNECTON的2024年度上市计划，已开始试销	●在乙炔炭黑领域，扩大在锂离子电池和电缆用途等成长市场的销售 ●保持并强化市场有望进一步扩大的用于xEV电机陶瓷球轴承的氮化硅的全球第一市场份额 ●实现HITTPLATE一般工业用高导热产品 (超20W) 的商业化 ●实现半导体制造和检测设备用新型发射器的商业化 ●由于进入预想的次世代高速通信的时代，使LCP薄膜和SNECTON在市场上成为业界标杆	●作为特种产品在市场上建立压倒性存在感，成为业界标杆 ●针对大趋势领域的“最佳材料的及时开发和提供” ●通过ESG/SDGs经营，实现可持续社会
xEV和 可再生能源	●乙炔炭黑 ●球状氧化铝 ●氮化硅 ●氮化硅基板			

SWOT分析

- 通过丰富的产品线，满足客户多样化的需求
- 较高产品市场份额所带来的信息优势
- 高温控制技术、氮化技术、球状化技术、烧制技术等各方面的关键技术

优势 S O 机遇

- IoT和自动驾驶等通信领域对重要性和高速性不断提升的要求
- 顺应xEV、可再生能源等脱碳社会的潮流

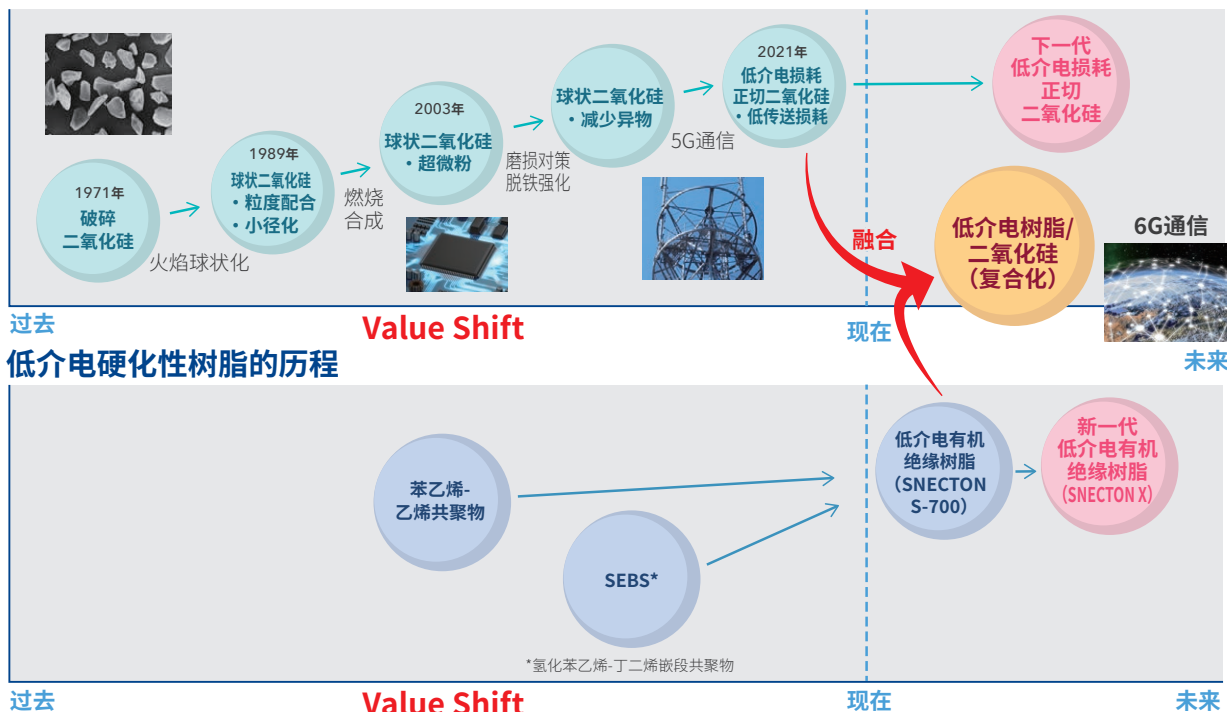
劣势 W T 风险

- 市场极速扩大带来的设备投资负担增加

- 新材料所带来的市场洗牌的可能性
- 环保政策等因素导致的技术开发趋势的大转换
- 以新兴国有企业为首的竞争对手的增加

球状二氧化硅的历程

Material/Process Innovation

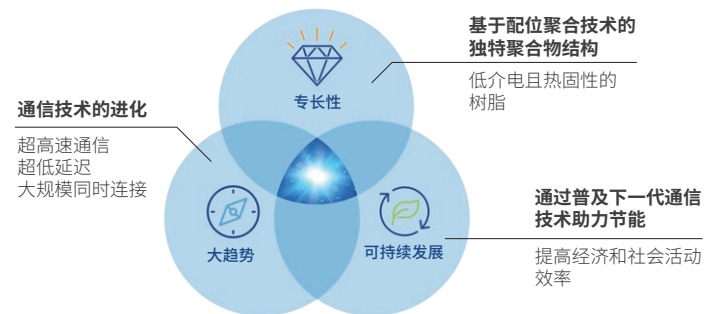


通过业务为社会做贡献

●低介电有机绝缘材料“SNECTON”与低介电正切、低传送损耗二氧化硅填料

下一代移动通信技术被视为引领社会重大变革的先锋。在推广过程中，提升接收电波的电子设备和终端性能成为了一大挑战。电化凭借自身的配位聚合技术，开发出了低介电有机绝缘材料“SNECTON”，这一材料正吸引着业界的目光，有望成为解决这一难题的关键。

它最初是一种热塑性树脂，会随热变软。但我们根据实际需求，巧妙地将其改造为热固性树脂。与此同时，我们还在不断致力于进一步降低其介电性。作为软质树脂，“Snecton”不仅拥有顶级的低介电性和优异的耐热性，还与其他低介电材料有良好的相容性，易于配合和成型加工。因此，它在下一代高频高速通信基板、封装内的绝缘材料、天线材料等领域的应用前景备受期待。将其与已在市场上占据高份额的二氧化硅填料融合，并以最佳配比提供给客户，这正是拥有有机和无机双重技术的电化公司的独特优势。



SNECTON
(低介电大分子单体/
Low Dielectric
Macromonomer: LDM)